

**附件六**

**智慧製造應用競賽-企劃書 書寫說明**

* **請依下列各項順序填寫(每大項皆需填寫，次項標題自行斟酌增刪)**
1. 摘要

含背景簡介、設計構想、設計原理、製作可行性與預期實作結果等概要陳述，須至少符合8項技術關聯及特點之一。(精密製造應用、彈性製造應用、跨領域技術整合、智慧感測、智慧控制、多系統物聯及控制、智慧機器人、虛實合一應用)，且能讓評審在短時間內抓到此專題實作之重點，如論文之abstract。

1. 設計概念

作品設計之創意性等說明

1. 系統架構

如架構圖、系統功能描述、電路控制邏輯及軟硬體規劃等之說明。

1. 設計簡圖(含3D Cad圖檔/設計計算資料)

含機構設計圖、設計原理說明、3D Cad圖檔、設計計算資料。以上設計資料需**完整**呈現高明鐵免費提供之零組件資訊(以設計圖顯示安裝位置及表列品名、規格、數量等)

1. 機電控制

如作品軟硬體系統規格說明與效能描述。

1. 作品特色與價值說明

本作品特色、效益與未來目標說明

1. 結論
2. 參考文獻

 ※ 構想企劃書本文介於8~15頁-Word與PDF檔、A4 規格

* 字體為標楷體【壹、(14點)】、【一、與內文皆為(12點)】
* 書面報告檔名統一為: 2017G\_(隊名)